

2025-2031年中国集成电路 行业前景展望与投资前景分析报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2025-2031年中国集成电路行业前景展望与投资前景分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202504/481968.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

集成电路（Integrated Circuit）是一种微型电子器件或部件。是典型的知识密集型、技术密集型、资本密集和人才密集型的高科技产业。经过30多年的发展，我国集成电路产业已初步形成了设计、芯片制造和封测三业并举、较为协调的发展格局，产业链基本形成。

中企顾问网发布的《2025-2031年中国集成电路行业前景展望与投资前景分析报告》共十九章。首先介绍了集成电路概念以及发展环境，接着分析了国际国内集成电路产业现状以及主要产品系统解析，然后具体介绍了集成电路制造业、集成电路设计业、封装测试业、其他相关行业、区域市场、产业技术以及集成电路的应用。随后，报告对集成电路国内外重点企业经营情况及投资项目进行了深入的分析，最后对集成电路产业进行了投资价值评估并对未来发展前景做了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、工信部、商务部、财政部、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对集成电路产业有个系统的了解或者想投资集成电路相关产业，本报告是您不可或缺的重要工具。

报告目录：

第一章 集成电路基本概述

1.1 集成电路相关介绍

1.1.1 集成电路的定义

1.1.2 集成电路的分类

1.1.3 集成电路的地位

1.2 集成电路产业链剖析

1.2.1 集成电路产业链结构

1.2.2 集成电路核心产业链

1.2.3 集成电路生产流程图

第二章 2020-2024年中国集成电路发展环境分析

2.1 经济环境

2.1.1 宏观经济发展概况

2.1.2 工业经济运行情况

2.1.3 新兴产业发展态势

2.1.4 宏观经济发展展望

2.2 社会环境

2.2.1 移动网络运行状况

2.2.2 研发经费投入增长

2.2.3 科技人才发展状况

2.3 产业环境

2.3.1 电子信息制造业运行增速

2.3.2 电子信息制造业企业营收

2.3.3 电子信息制造业固定资产

2.3.4 电子信息制造业出口状况

第三章 集成电路产业政策环境发展分析

3.1 政策体系分析

3.1.1 管理体系

3.1.2 政策汇总

3.1.3 发展规范

3.2 重要政策解读

3.2.1 集成电路进口税收政策

3.2.2 集成电路设计等企业条件

3.2.3 集成电路企业清单制定要求

3.3 相关政策分析

3.3.1 推进双一流建设的意见

3.3.2 中国制造行业发展目标

3.3.3 “十四五”智能制造发展规划

3.3.4 “十四五”数字经济发展规划

3.4 地区发展规划分析

3.4.1 长三角地区

3.4.2 环渤海经济区

3.4.3 珠三角地区

3.4.4 中西部地区

第四章 2020-2024年全球集成电路产业发展分析

4.1 全球集成电路产业分析

4.1.1 产业发展现状

4.1.2 市场发展规模

4.1.3 细分市场占比

4.1.4 区域分布状况

4.1.5 市场竞争格局

4.1.6 行业发展趋势

4.2 美国集成电路产业分析

4.2.1 产业政策环境

4.2.2 产业发展现状

4.2.3 市场份额分布

4.2.4 产业研发投入

4.2.5 资本支出状况

4.2.6 产业人才状况

4.3 韩国集成电路产业分析

4.3.1 产业发展阶段

4.3.2 产业政策环境

4.3.3 产业发展现状

4.3.4 市场贸易状况

4.3.5 产业发展战略

4.4 日本集成电路产业分析

4.4.1 产业政策环境

4.4.2 产业发展概况

4.4.3 细分产业状况

4.4.4 市场贸易状况

4.4.5 对外贸易制裁

4.5 中国台湾集成电路产业

4.5.1 产业规模状况

4.5.2 市场结构分布

4.5.3 产业贸易状况

4.5.4 典型企业运行

4.5.5 发展经验启示

第五章 2020-2024年中国集成电路产业发展分析

5.1 集成电路产业发展特征

5.1.1 生产工序多

5.1.2 产品种类多

5.1.3 技术更新快

5.1.4 投资风险高

5.2 2020-2024年中国集成电路产业运行状况

5.2.1 产业发展历程

5.2.2 行业发展态势

5.2.3 产业销售规模

5.2.4 人才需求规模

5.2.5 主要区域布局

5.2.6 企业布局状况

5.2.7 行业竞争情况

5.3 2020-2024年全国集成电路产量分析

5.3.1 2020-2024年全国集成电路产量趋势

5.3.2 2024年全国集成电路产量情况

5.3.3 2024年全国集成电路产量情况

5.3.4 2024年全国集成电路产量情况

5.3.5 集成电路产量分布情况

5.4 2020-2024年中国集成电路进出口数据分析

5.4.1 进出口总量数据分析

5.4.2 主要贸易国进出口情况分析

5.4.3 主要省市进出口情况分析

5.5 集成电路产业核心竞争力提升方法

5.5.1 提高扶持资金集中运用

5.5.2 制定行业融资投资制度

5.5.3 逐渐提高政府采购力度

5.5.4 建立技术中介服务制度

5.5.5 重视人才引进人才培养

5.6 中国集成电路产业发展思路解析

- 5.6.1 产业发展问题
- 5.6.2 产业发展建议
- 5.6.3 产业发展策略
- 5.6.4 产业突破方向
- 5.6.5 产业创新发展

第六章 2020-2024年集成电路行业细分产品介绍

- 6.1 逻辑器件
 - 6.1.1 CPU
 - 6.1.2 GPU
 - 6.1.3 FGPA
- 6.2 微处理器（MPU）
 - 6.2.1 AP（APU）
 - 6.2.2 DSP
 - 6.2.3 MCU
- 6.3 存储器
 - 6.3.1 存储器基本概述
 - 6.3.2 存储器市场规模
 - 6.3.3 存储器细分市场
 - 6.3.4 存储器竞争格局
 - 6.3.5 存储器进出口数据
 - 6.3.6 存储器发展机遇

第七章 2020-2024年模拟集成电路产业分析

- 7.1 模拟集成电路的特点及分类
 - 7.1.1 模拟集成电路的特点
 - 7.1.2 模拟集成电路的分类
 - 7.1.3 信号链路的工作流程
 - 7.1.4 模拟集成电路的使用
- 7.2 全球模拟集成电路发展状况
 - 7.2.1 市场发展规模
 - 7.2.2 市场出货状况

- 7.2.3 区域分布状况
- 7.2.4 平均售价情况
- 7.2.5 市场竞争格局
- 7.2.6 下游应用状况
- 7.3 中国模拟集成电路发展分析
 - 7.3.1 市场规模状况
 - 7.3.2 市场竞争格局
 - 7.3.3 市场国产化率
 - 7.3.4 行业投资状况
 - 7.3.5 项目投资动态
- 7.4 国内典型企业发展案例分析
 - 7.4.1 企业发展概况
 - 7.4.2 主营业务状况
 - 7.4.3 企业经营状况
 - 7.4.4 核心竞争力分析
 - 7.4.5 企业布局动态
 - 7.4.6 未来发展战略
- 7.5 模拟集成电路发展前景分析
 - 7.5.1 政策利好产业发展
 - 7.5.2 市场需求持续增长
 - 7.5.3 技术发展逐步提速
 - 7.5.4 新生产业发展加快

第八章 2020-2024年集成电路产业链上游——集成电路设计业分析

- 8.1 集成电路设计基本流程
- 8.2 2020-2024年中国集成电路设计行业运行状况
 - 8.2.1 行业发展历程
 - 8.2.2 市场发展规模
 - 8.2.3 区域分布状况
 - 8.2.4 从业人员规模
 - 8.2.5 人才供需情况
 - 8.2.6 行业发展问题

8.3 集成电路设计业市场竞争格局

8.3.1 全球竞争格局

8.3.2 企业数量规模

8.3.3 城市发展格局

8.4 集成电路设计重点软件行业

8.4.1 EDA软件基本概念

8.4.2 EDA行业发展历程

8.4.3 全球EDA市场规模

8.4.4 全球EDA市场构成

8.4.5 中国EDA市场规模

8.4.6 中国EDA人才情况

8.4.7 EDA行业竞争格局

8.5 集成电路设计产业园区介绍

8.5.1 深圳集成电路设计应用产业园

8.5.2 北京中关村集成电路设计园

8.5.3 粤澳集成电路设计产业园

8.5.4 上海集成电路设计产业园

第九章 2020-2024年集成电路产业链中游——集成电路制造业分析

9.1 集成电路制造业相关概述

9.1.1 集成电路制造基本概念

9.1.2 集成电路制造工艺流程

9.1.3 集成电路制造驱动因素

9.1.4 集成电路制造业重要性

9.2 2020-2024年中国集成电路制造业运行状况

9.2.1 市场发展规模

9.2.2 行业所需设备

9.2.3 行业产线分布

9.2.4 行业壁垒分析

9.3 2020-2024年晶圆代工产业发展分析

9.3.1 全球市场规模

9.3.2 全球产能情况

- 9.3.3 全球竞争格局
- 9.3.4 中国市场规模
- 9.3.5 国内市场份额
- 9.3.6 行业技术趋势
- 9.4 集成电路制造业发展问题分析
 - 9.4.1 市场份额较低
 - 9.4.2 产业技术落后
 - 9.4.3 行业人才缺乏
 - 9.4.4 质量管理问题
- 9.5 集成电路制造业发展思路及建议策略
 - 9.5.1 行业发展总体策略分析
 - 9.5.2 行业制造设备发展思路
 - 9.5.3 工艺质量管理应对措施
 - 9.5.4 企业人才培养策略分析

第十章 2020-2024年集成电路产业链下游——封装测试行业分析

- 10.1 集成电路封装测试行业发展综述
 - 10.1.1 封装测试基本概念
 - 10.1.2 封装测试的重要性
 - 10.1.3 封装测试发展优势
 - 10.1.4 封装测试发展概况
- 10.2 中国集成电路封装测试市场发展分析
 - 10.2.1 市场规模分析
 - 10.2.2 产品价格分析
 - 10.2.3 行业竞争情况
 - 10.2.4 典型企业布局
 - 10.2.5 下游应用分析
 - 10.2.6 专利申请情况
- 10.3 集成电路封装测试设备市场发展分析
 - 10.3.1 封装测试设备主要类型
 - 10.3.2 全球封测设备市场规模
 - 10.3.3 全球封测设备企业布局

- 10.3.4 封装设备行业发展分析
- 10.3.5 测试设备行业发展分析
- 10.3.6 封测设备国产化率分析
- 10.3.7 封测设备企业经营分析
- 10.4 集成电路封装测试业技术发展分析
 - 10.4.1 关键技术研发突破
 - 10.4.2 行业技术存在挑战
 - 10.4.3 未来技术发展趋势
- 10.5 集成电路封装测试行业发展前景分析
 - 10.5.1 高密度封装
 - 10.5.2 高可靠性
 - 10.5.3 低成本

第十一章 2020-2024年集成电路其他相关行业分析

- 11.1 2020-2024年传感器行业分析
 - 11.1.1 产业链结构分析
 - 11.1.2 市场发展规模
 - 11.1.3 市场结构分析
 - 11.1.4 市场竞争格局
 - 11.1.5 市场产业园区
 - 11.1.6 区域分布格局
 - 11.1.7 专利申请情况
 - 11.1.8 未来发展趋势
- 11.2 2020-2024年分立器件行业分析
 - 11.2.1 市场产业链条
 - 11.2.2 市场供给状况
 - 11.2.3 市场需求规模
 - 11.2.4 市场供需分析
 - 11.2.5 市场贸易分析
 - 11.2.6 行业竞争格局
 - 11.2.7 行业专利申请
 - 11.2.8 行业发展壁垒

- 11.2.9 未来发展展望
- 11.3 2020-2024年光电器件行业分析
 - 11.3.1 行业基本概述
 - 11.3.2 行业政策环境
 - 11.3.3 行业产量规模
 - 11.3.4 进出口贸易情况
 - 11.3.5 企业注册规模
 - 11.3.6 专利申请情况
 - 11.3.7 行业投融资规模
 - 11.3.8 行业发展策略
 - 11.3.9 行业发展趋势

第十二章 2020-2024年中国集成电路区域市场发展状况

- 12.1 北京
 - 12.1.1 行业发展现状
 - 12.1.2 产业空间布局
 - 12.1.3 产业竞争力分析
 - 12.1.4 行业发展困境
 - 12.1.5 战略发展目标
- 12.2 上海
 - 12.2.1 行业发展现状
 - 12.2.2 产业空间布局
 - 12.2.3 主要区域布局
 - 12.2.4 特色园区发展
 - 12.2.5 产业竞争力分析
 - 12.2.6 行业发展困境
 - 12.2.7 行业发展建议
 - 12.2.8 行业发展展望
- 12.3 深圳
 - 12.3.1 行业发展现状
 - 12.3.2 产业空间布局
 - 12.3.3 资金投入情况

12.3.4 设计行业发展

12.3.5 战略发展目标

12.4 杭州

12.4.1 行业政策发布

12.4.2 产业发展规模

12.4.3 行业发展特点

12.4.4 服务中心建设

12.4.5 项目建设动态

12.4.6 行业发展建议

12.5 成都

12.5.1 行业政策发布

12.5.2 产业链现状图谱

12.5.3 产业发展现状

12.5.4 主要区域布局

12.5.5 行业发展前景

12.6 其他地区

12.6.1 江苏省

12.6.2 重庆市

12.6.3 武汉市

12.6.4 合肥市

12.6.5 广州市

第十三章 2020-2024年集成电路技术发展分析

13.1 集成电路技术发展历程

13.1.1 科学技术基础阶段

13.1.2 创新迅速发展阶段

13.1.3 技术创新方向阶段

13.1.4 新一轮集成电路发展

13.2 集成电路前道制造工艺技术

13.2.1 微细加工技术

13.2.2 电路互联技术

13.2.3 器件特性的退化

- 13.3 集成电路后道制造工艺技术
 - 13.3.1 3D集成技术
 - 13.3.2 晶圆级封装
- 13.4 集成电路的ESD防护技术
 - 13.4.1 集成电路的ESD现象成因
 - 13.4.2 集成电路ESD的防护器件
 - 13.4.3 基于SCR的防护技术分析
 - 13.4.4 集成电路全芯片防护技术
- 13.5 集成电路其他相关技术发展
 - 13.5.1 MOSFET器件性能提升技术
 - 13.5.2 器件集成度提升技术
 - 13.5.3 寄生效应抑制技术
 - 13.5.4 化学机械抛光技术
- 13.6 集成电路技术发展趋势及前景展望
 - 13.6.1 发展制约因素
 - 13.6.2 技术发展前景
 - 13.6.3 技术发展趋势
 - 13.6.4 技术市场展望
 - 13.6.5 技术发展方向

第十四章 2020-2024年集成电路应用市场发展状况

- 14.1 通信行业
 - 14.1.1 通信行业总体运行状况
 - 14.1.2 通信行业用户发展规模
 - 14.1.3 通信行业基础设施建设
 - 14.1.4 通信行业集成电路应用
- 14.2 消费电子
 - 14.2.1 消费电子产业发展规模
 - 14.2.2 消费电子行业发展热点
 - 14.2.3 消费电子企业经营情况
 - 14.2.4 消费电子投融资情况分析
 - 14.2.5 消费电子行业集成电路应用

14.2.6 消费电子产业未来发展趋势

14.3 汽车电子

14.3.1 汽车电子相关概述

14.3.2 汽车电子产业环境

14.3.3 汽车电子产业链条

14.3.4 汽车电子市场规模

14.3.5 汽车电子成本分析

14.3.6 汽车电子竞争格局

14.3.7 集成电路的应用分析

14.3.8 汽车电子前景展望

14.4 物联网

14.4.1 物联网产业核心地位

14.4.2 物联网政策支持分析

14.4.3 物联网产业规模状况

14.4.4 集成电路的应用分析

14.4.5 物联网未来发展趋势

第十五章 2020-2024年国外集成电路产业重点企业经营分析

15.1 英特尔 (Intel)

15.1.1 企业发展概况

15.1.2 2024财年企业经营状况分析

15.1.3 2024财年企业经营状况分析

15.1.4 2024财年企业经营状况分析

15.1.5 企业业务布局

15.1.6 企业技术创新

15.2 亚德诺 (Analog Devices)

15.2.1 企业发展概况

15.2.2 2024财年企业经营状况分析

15.2.3 2024财年企业经营状况分析

15.2.4 2024财年企业经营状况分析

15.2.5 企业发展动态

15.3 海力士半导体 (MagnaChip Semiconductor Corp.)

- 15.3.1 企业发展概况
- 15.3.2 2024年海力士经营状况分析
- 15.3.3 2024年海力士经营状况分析
- 15.3.4 2024年海力士经营状况分析
- 15.3.5 企业业务布局
- 15.3.6 对华发展动态
- 15.4 德州仪器 (Texas Instruments)
- 15.4.1 企业发展概况
- 15.4.2 2024年企业经营状况分析
- 15.4.3 2024年企业经营状况分析
- 15.4.4 2024年企业经营状况分析
- 15.4.5 企业项目动态
- 15.4.6 企业财务战略
- 15.5 意法半导体 (STMicroelectronics N.V.)
- 15.5.1 企业发展概况
- 15.5.2 2024财年企业经营状况分析
- 15.5.3 2024财年企业经营状况分析
- 15.5.4 2024财年企业经营状况分析
- 15.5.5 企业合作动态
- 15.6 英飞凌科技公司 (Infineon Technologies AG)
- 15.6.1 企业发展概况
- 15.6.2 2024财年企业经营状况分析
- 15.6.3 2024财年企业经营状况分析
- 15.6.4 2024财年企业经营状况分析
- 15.6.5 企业合作动态
- 15.6.6 企业投资动态
- 15.7 恩智浦 (NXP Semiconductors N.V.)
- 15.7.1 企业发展概况
- 15.7.2 2024财年企业经营状况分析
- 15.7.3 2024财年企业经营状况分析
- 15.7.4 2024财年企业经营状况分析
- 15.7.5 企业发展动态

第十六章 2020-2024年中国集成电路产业重点企业经营分析

16.1 深圳市海思半导体有限公司

16.1.1 企业发展概况

16.1.2 企业经营状况

16.1.3 产品出货规模

16.1.4 业务调整动态

16.2 中芯国际集成电路制造有限公司

16.2.1 企业发展概况

16.2.2 经营效益分析

16.2.3 业务经营分析

16.2.4 财务状况分析

16.2.5 核心竞争力分析

16.2.6 公司发展战略

16.2.7 未来前景展望

16.3 紫光国芯微电子股份有限公司

16.3.1 企业发展概况

16.3.2 经营效益分析

16.3.3 业务经营分析

16.3.4 财务状况分析

16.3.5 核心竞争力分析

16.3.6 未来前景展望

16.4 杭州士兰微电子股份有限公司

16.4.1 企业发展概况

16.4.2 经营效益分析

16.4.3 业务经营分析

16.4.4 财务状况分析

16.4.5 核心竞争力分析

16.4.6 公司发展战略

16.5 北京兆易创新科技股份有限公司

16.5.1 企业发展概况

16.5.2 经营效益分析

- 16.5.3 业务经营分析
- 16.5.4 财务状况分析
- 16.5.5 核心竞争力分析
- 16.5.6 公司发展战略
- 16.5.7 未来前景展望
- 16.6 深圳市汇顶科技股份有限公司
 - 16.6.1 企业发展概况
 - 16.6.2 经营效益分析
 - 16.6.3 业务经营分析
 - 16.6.4 财务状况分析
 - 16.6.5 核心竞争力分析
 - 16.6.6 公司发展战略
 - 16.6.7 未来前景展望

第十七章 中国集成电路产业典型项目投资建设深度解析

- 17.1 高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目
 - 17.1.1 项目基本概况
 - 17.1.2 项目的必要性
 - 17.1.3 项目投资概算
 - 17.1.4 项目进度安排
 - 17.1.5 项目实施地点
 - 17.1.6 项目环境保护
 - 17.1.7 项目经济效益
- 17.2 集成电路成品率技术升级开发项目
 - 17.2.1 项目基本概况
 - 17.2.2 项目的必要性
 - 17.2.3 项目的可行性
 - 17.2.4 项目投资概算
 - 17.2.5 项目进度安排
 - 17.2.6 项目建设内容
- 17.3 集成电路生产测试项目
 - 17.3.1 项目基本概况

- 17.3.2 项目的必要性
- 17.3.3 项目的可行性
- 17.3.4 项目投资概算
- 17.3.5 项目进度安排
- 17.3.6 项目环境保护
- 17.4 上海安集集成电路材料基地项目
 - 17.4.1 项目基本概况
 - 17.4.2 项目的必要性
 - 17.4.3 项目的可行性
 - 17.4.4 项目投资概算
 - 17.4.5 项目进度安排
 - 17.4.6 项目增产情况
 - 17.4.7 项目购置设备
 - 17.4.8 项目用地规划

第十八章 对集成电路产业投资价值评估及建议

- 18.1 中国集成电路产业投融资规模分析
 - 18.1.1 投融资规模变化趋势
 - 18.1.2 投融资轮次分布情况
 - 18.1.3 投融资省市分布情况
 - 18.1.4 投融资事件比较分析
 - 18.1.5 主要投资机构排行分析
 - 18.1.6 政府基金投入情况分析
 - 18.1.7 行业投融资发展建议
- 18.2 对集成电路产业投资机遇分析
 - 18.2.1 万物互联形成战略新需求
 - 18.2.2 人工智能开辟技术新方向
 - 18.2.3 协同开放构建研发新模式
 - 18.2.4 新旧力量塑造竞争新格局
- 18.3 对集成电路产业进入壁垒评估
 - 18.3.1 竞争壁垒
 - 18.3.2 技术壁垒

- 18.3.3 资金壁垒
- 18.4 对集成电路产业投资价值评估及投资建议
 - 18.4.1 投资价值综合评估
 - 18.4.2 市场机会矩阵分析
 - 18.4.3 产业进入时机分析
 - 18.4.4 产业投资风险剖析
 - 18.4.5 产业投资策略建议

第十九章 2025-2031年集成电路产业发展趋势及前景预测

- 19.1 对集成电路产业发展动力评估
 - 19.1.1 经济因素
 - 19.1.2 政策因素
 - 19.1.3 技术因素
- 19.2 集成电路产业未来发展前景展望
 - 19.2.1 产业发展机遇
 - 19.2.2 产业战略布局
 - 19.2.3 产品发展趋势
 - 19.2.4 产业模式变化
- 19.3 对2025-2031年中国集成电路产业预测分析
 - 19.3.1 2025-2031年中国集成电路产业影响因素分析
 - 19.3.2 2025-2031年中国集成电路产业销售额预测

图表目录

- 图表1 模拟集成电路与数字集成电路的区别
- 图表2 集成电路产业链及部分企业
- 图表3 集成电路生产流程
- 图表4 2020-2024年国内生产总值及其增长速度
- 图表5 2020-2024年三次产业增加值占国内生产总值比重
- 图表6 2024年GDP初步核算数据
- 图表7 2020-2024年GDP同比增长速度
- 图表8 2020-2024年GDP环比增长速度
- 图表9 2020-2024年全部工业增加值及其增长速度

- 图表10 2024年主要工业产品产量及其增长速度
- 图表11 2020-2024年规模以上工业增加值同比增长速度
- 图表12 2020-2024年研究与试验发展（R&D）经费支出及其增长速度
- 图表13 2020-2024年电子信息制造业和工业增加值增速情况
- 图表14 2020-2024年电子信息制造业和工业增加值分月增速情况
- 图表15 2020-2024年电子信息制造业和工业增加值累计增速
- 图表16 2020-2024年电子信息制造业和工业企业利润总额增速情况
- 图表17 2020-2024年电子信息制造业营业收入、利润总额累计增速
- 图表18 2020-2024年电子信息制造业和制造业固定资产投资增速情况
- 图表19 2020-2024年电子信息制造业和工业固定资产投资累计增速
- 图表20 2020-2024年电子信息制造业和工业企业出口交货值增速情况
- 图表21 2020-2024年电子信息制造业和工业出口交货值累计增速
- 图表22 2020-2024年国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（一）
- 图表23 2020-2024年国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（二）
- 图表24 2020-2024年国家层面集成电路行业政策及重点内容解读（三）
- 图表25 “十四五”以来集成电路行业重点规划解读
- 图表26 《中国制造2024》关于集成电路行业发展目标
- 图表27 2020-2024年主要国家/地区半导体研发支出占销售收入的比重变化
- 图表28 2020-2024年全球集成电路市场规模
- 图表29 2024年全球集成电路产品细分市场规模占比情况
- 图表30 2024年全球IC企业市场份额区域分布

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202504/481968.html>